

Maxsil 600T

厚膜対応透明絶縁膜コーティング液

特長

- 100 μm の厚膜が成膜可能
- 無溶媒対応、低収縮・低応力
- 優れた耐熱性(250°C)
- 優れた透明性 (95% @ 10 μm 以上)
- 優れた絶縁性
- 低い脱ガス
- 低温(200~250°C)プロセッシング可能

応用例

- ポリイミド基板の平坦化・絶縁パッシベーション
- LCD/OLED 用 TFT アレイの平坦化絶縁保護膜

使用方法【推奨条件】

基板洗浄→塗布（スピンコート/スリットコート）→プリベーク(150°C x 1 min)→キュアベーク(200~250°C x 30 min, 大気中)

特性表

主溶剤	無溶媒, PGMEA 希釈可能	密着性	ガラス	5B (100%剥がれ無)
固形分量	10~100 wt% (調節可)	薬液耐性	PGMEA	変化なし
薬液寿命	3ヶ月 (4°C保存)		DMSO	変化なし
粘度(20°C)	500 mPa·s (100 wt%品)		MEA	僅かに溶解(2~3 nm/min)
最大膜厚	100 μm		TOK 106	変化なし
屈折率	1.54 (typ.) @ 550 nm		5% 蔞酸; 35°C	変化なし
透過率	95~96% (300~800 nm)		2.38%TMAH; 20°C	変化なし
絶縁耐圧(電界強度)	~ 2.2 MV/cm @ 1 μA	耐熱性	250°Cまで	重量減少 < 0.5 %
誘電率	4.1 (@ 1 MHz)		300°C 10 min	重量減少 < 1.7 %

開発・製造元

マックス電子材料株式会社